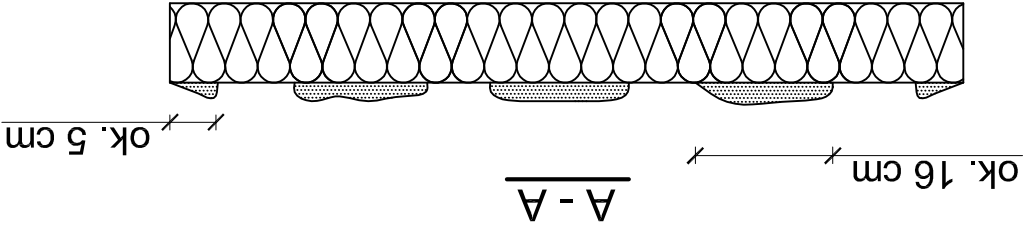
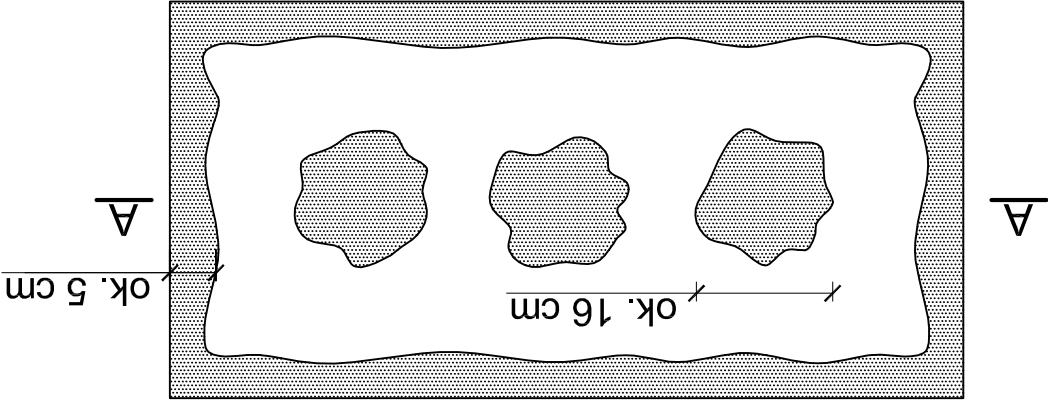
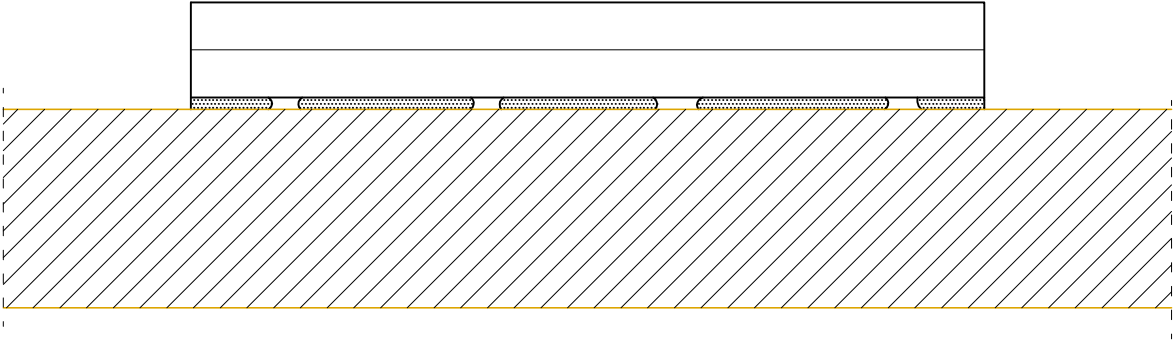


Sposób klejenia płyt izolacji termicznej.



Uwagi :

Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoży nienastakliwych i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych. Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględnić odchyłki do równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju(ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzduż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni.

Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoz izolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).

Uwagi!
Jednoczesne stosowanie materiałów
różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Białutna 22 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax.(041) 265 40 62		mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		227/KL/72		Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul Moniuszki 6 67 - 200 GŁOGÓW		Branża: ARCHITEKTURA Skala: 1:10	
Projektował:	mgr inż. Sylvia Piwowarska	---		Rodzaj projektu		Adres Budowy: BUDYNEK MIESZKALNY ul Moniuszki 6 67 - 200 GŁOGÓW		PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI	
Opracował:								SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE	
Opracował:								Data opracowania: LIPIEC 2010r.	
Sprawdził:									